



PANEL THERMOCHIP

PANEL THERMOCHIP	e total (mm)	RT (m2K/W)	U (W/m2K)	Peso (kg/m2)	Peso (kg/panel)	*3 apoyos L=1250	
						Carga max. (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)
TAOt/19-80-15_WF 80mm	114,45	2,29	0,44	31,29	43,02	1918,00	189,00
TAOt/19-100-15_WF 100mm	134,45	2,79	0,36	34,09	46,87	1936,00	205,00
TAOt/19-120-15_WF 120mm	154,45	3,29	0,30	36,89	50,72	1974,00	214,00
TAOt/19-140-15_WF 140mm	174,45	3,79	0,26	39,69	54,57	1990,00	231,00
TAOt/19-160-15_WF 160mm	194,45	4,29	0,23	42,49	58,42	>1990,00	>231,00
TAOt/19-180-15_WF 180mm	214,45	4,79	0,21	45,29	62,27	>1990,00	>231,00

*Resistencia mecánica, cargas positivas en apoyos. L en mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tablero exterior - OSB3

Espesor	e (mm)	15
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,1
Densidad	D (kg/m3)	570
Difusión al vapor de agua	μ	90-150
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700

Núcleo aislante - Fibra de madera

Espesor	e (mm)	80	100	120	140	160	180
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041
Densidad	D (kg/m3)	145	145	145	145	145	145
Difusión al vapor de agua	μ	3	3	3	3	3	3
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	2100	2100	2100	2100	2100	2100

Barrera de vapor

Espesor	e (mm)	0,045
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,25
Densidad	D (kg/m3)	311
Difusión al vapor de agua	μ	10
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1000

Tablero interior - Tarima de Abeto

Espesor	e (mm)	19
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,15
Densidad	D (kg/m3)	600
Difusión al vapor de agua	μ	20
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1600